

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2025-039

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金专户初始金额	120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额	9,745.50
减：超募资金使用金额	41,010.00

其中：本年度超募资金使用金额	0.00
减：暂时性补充流动资金	16,000.00
其中：本年度暂时性补充流动资金	0.00
加：归还暂时性补充流动资金	16,000.00
其中：本年度归还暂时性补充流动资金	6,000.00
加：利息收入、手续费支出净额	4,151.29
其中：本年度利息收入、手续费支出净额	401.90
减：累计投资金额	20,015.19
其中：本年度投资金额	4,221.95
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	10,944.63
截至 2025 年 6 月 30 日非募集资金专户现金管理余额	43,400.00

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司合肥分行	551905680810909	318.97	现金管理
合肥科技农村商业银行股份有限公司 高新区支行	200101131934666000002 7	257.66	现金管理

银行名称	银行账号	余额	备注
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	340.04	现金管理
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801200001310	24.30	现金管理
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	9,626.04	非现金管理
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	377.63	现金管理
合计	—	10,944.63	-

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月16日召开公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚

动使用。

截至2025年6月30日，公司尚存447,185,976.45元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	截至报告期末 现金管理余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	结构性存款	保本浮动收益	2025/5/12	2025/8/12	14,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	大额存单	保本固定收益	2025/2/17	2025/8/17	70,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	大额存单	保本固定收益	2025/5/19	2025/11/19	30,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2025/3/7	2025/9/7	50,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	保本浮动收益	2025/4/7	2025/7/7	100,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2025/5/9	2025/8/7	30,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
招商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	保本浮动收益	2025/5/21	2025/8/21	40,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
国元证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	2025/6/6	2025/8/27	15,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	2025/2/28	2026/2/26	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	2025/2/28	2026/2/26	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	2025/5/12	2025/7/10	10,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
中信证券股份有	收益	保本	2025/5/19	2025/7/21	15,000,000.00	非募集资金

限公司	凭证	固定收益				专户现金管理余额
国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	2025/4/29	2025/7/28	20,000,000.00	非募集资金专户现金管理余额
招商银行股份有限公司合肥分行	协定存款	保本浮动收益	2025/4/18	2026/4/17	3,189,685.55	募集资金专户余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2024/9/29	2025/9/29	2,576,552.27	募集资金专户余额
中信银行股份有限公司合肥分行	协定存款	保本浮动收益	2024/9/25	2025/9/25	3,400,438.04	募集资金专户余额
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	协定存款	保本浮动收益	2024/9/29	2025/9/28	3,776,271.06	募集资金专户余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	协定存款	保本浮动收益	2025/5/20	2026/5/20	243,029.53	募集资金专户余额
合计	——	——	——	——	447,185,976.45	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。截至2025年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为3,672.02万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年12月27日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将募投项目“NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2027年7月、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月、“CiNOR 存算一体AI推理芯片研发项目”变更为“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月，并对内部投资结构进行调整。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日止

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额				120,964.04		本年度投入募集资金总额						4,221.95	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						29,760.69	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
闪存芯片升级研发及产业化项目	是	20,318.00	不适用	20,318.00	2,687.33	11,683.66	-8,634.34	57.50	2027 年 7 月	不适用	不适用	是，详见公司于 2024 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-076）	
MCU 芯片升级研发及产业化项目	是	17,731.00	不适用	17,731.00	1,075.63	5,003.03	-12,727.97	28.22	2028 年 1 月	不适用	不适用		
面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目	是	12,339.00	不适用	12,339.00	299.41	2,589.95	-9,749.05	20.99	2028 年 1 月	不适用	不适用		
发展与科技储备项目	否	25,000.00	不适用	25,000.00	159.58	10,484.05	-14,515.95	41.94	—	不适用	不适用	否	

承诺投资项目小计	否	75,388.00	不适用	75,388.00	4,221.95	29,760.69	-45,627.31	39.48	—	-	-	-
超募资金投向：												
超募资金-暂未确定投向	否	4,566.04	不适用	4,566.04	-	-	-4,566.04	-	—	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	13,670.00	不适用	13,670.00	-	13,670.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	27,340.00	不适用	27,340.00	-	27,340.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	-	120,964.04	不适用	120,964.04	4,221.95	70,770.69	-50,193.35	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。											

注 1：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，并非计算错误。

注 2：根据公司发展战略与实际情况，公司将原有募集资金项目 NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目、通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目、CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目变更为闪存芯片升级研发及产业化项目、MCU 芯片升级研发及产业化项目、面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目，上述项目的变更不涉及投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点的变更，仅涉及募集资金投资项目范围的扩大，不涉及变更用途。

附表 2:

2025 年半年变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
闪存芯片升级研发及产业化项目	NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2,687.33	11,683.66	57.50	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
MCU 芯片升级研发及产业化项目	通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	1,075.63	5,003.03	28.22	2028 年 1 月	不适用	不适用	否
面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目	CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	299.41	2,589.95	20.99	2028 年 1 月	不适用	不适用	否
合计	-	50,388.00	50,388.00	4,062.37	19,276.64	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目变更原因：随着行业技术的快速发展和市场环境的变化，由于该投资项目所指定的行业技术限定的范围较狭窄，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险，为确保资金的有效利用和项目预期效益的实现，公司认为有必要在原有项目的基础上进行变更。</p> <p>通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目变更原因：通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目是基于公司 M0+内核的 32 位 MCU 产品，进一步研发通用 M3 和 M4 系列 MCU 产品，然而基于对市场环境和竞争格局的判断以及公司现有的研发市场积累，决定进一步完善消费类 MCU 的产品布局以增加产品竞争力和市场份额，同时基于电驱，电控，储能等巨大的市场机会以及国产替代需要的考量，公司将进一步研发马达控制，工业控制等领域的 32 位高性能 MCU，新的应用领域所选择的 CPU 内核不局限于 M3 和 M4 内核。</p>							

	<p>CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目变更原因：本项目系基于此前消费市场环境、端侧智能物联网发展趋势以及公司未来发展战略等因素制定，总体尚处于端侧存算一体芯片的探索阶段，计划达产后将推动公司成功切入智能物联网市场，因此智能物联网市场情况以及端侧存算一体芯片发展情况对于公司原项目的资金投入和研发推进有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及技术格局发生了较大变化：随着 TinyML 赋能低成本 MCU 完成 AI 任务市场对于存算一体芯片的性能预期进一步提高；生成式大模型的爆发为存算一体芯片提出了新的要求，面向大模型的复杂任务，单一的存储介质已无法独立满足现有算法的全部计算需求，需要多种介质相互融合、共同协调，提高了芯片设计的复杂度。此外下游产品市场竞争态势和硬件技术发展情况尚有较大的完善空间， 综上因素对公司产品推进节奏产生一定影响。</p> <p>2024 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，并经 2025 年 1 月 13 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-076）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用